



# GFIE Groupement des Fournisseurs de l'Industrie Electronique

Siège Social : 13, rue Hamelin - F 75783 Paris Cedex 16 - <http://www.gfie.fr> - Email : [info@gfie.fr](mailto:info@gfie.fr)

M. Jean-Pierre VELLY – Tél/Fax ; 01 64 09 92 21 - Mob. : 06 07 46 54 19 - Email : [jpvelly@gfie.fr](mailto:jpvelly@gfie.fr)

## PROGRAMME DE LA JOURNEE TECHNIQUE DU GFIE

Le GFIE (Groupement des Fournisseurs de l'Industrie Electronique) organise une journée technique autour du thème général de l'assemblage en électronique.

Les présentations sélectionnées sont originales, d'excellente qualité et apporteront des éléments nouveaux à tous ceux qui exercent des responsabilités dans le domaine de l'assemblage en électronique (ingénieurs et techniciens en fabrication, maintenance, services méthodes, contrôle, bureau d'études, ainsi que les services achats). Le programme technique figure en 2<sup>o</sup> page du présent document.

Le nombre de présentations a été limité afin de permettre aux participants de dialoguer avec les intervenants et entre eux.

### DETAILS PRATIQUES.

**Date:** Jeudi 2 Avril 2015, de 9 heures à 17 heures 30. Enregistrement à partir de 8 heures 30.

### Lieu:

Espace Hamelin (salle du Conseil), 17 rue de l'Amiral Hamelin, 75016 PARIS.

### Accès:

Métro: Stations BOISSIERE, IENA ou KLEBER.

Parking le plus proche: Parking Kleber, 65 avenue Kleber 75016 PARIS.

### INSCRIPTIONS.

Le nombre de participants étant limité, il est recommandé de s'inscrire le plus rapidement possible, et dans tous les cas avant le 27 Mars 2015.

Utiliser le formulaire ci-dessous ou le recopier et l'adresser avec un chèque correspondant aux frais de participation, établi au nom du GFIE à:

**GFIE, Service Comptabilité JT, 13 rue Hamelin, 75783 PARIS Cedex 16**

### FRAIS DE PARTICIPATION.

Cette participation aux frais inclut le déjeuner de midi et les rafraichissements ou café pendant les pauses.

150.00 € par personne

75.00 € par personne pour les membres du GFIE

FICHE D'INSCRIPTION (une fiche par participant)	
Nom:	Prénom:
Société:	Fonction dans la société:
Adresse	
Ville	Code postal:
Téléphone bureau:	
Téléphone portable:	
Email:	
Chèque de participation joint (€):	
Signature:	
→ Désire une note de débit acquittée au nom de la société	

.../...

Membre de la



FÉDÉRATION des INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ÉLECTRONIQUES et de COMMUNICATION



# PROGRAMME DES PRESENTATIONS.

## Journée technique du GFIE le 2 Avril 2015.

09:00 - 09:10	Introduction par Pierre-Jean ALBRIEUX, président du GFIE	
09:10 - 09:40	La nouvelle technologie émergente de l'électronique imprimée: une diversification ou une substitution aux technologies actuelles et l'assemblage des circuits électroniques ?	Patrick PEROCHAUD, ACCELONIX SAS.
09:40 - 10:10	Adhésif pour assemblages avec propriétés de dissipation thermique de haute fiabilité.	Florence PINATEL, PROTAVIC
10:10 - 10:40	PAUSE	
10:40 - 11:10	Miniaturisation et assemblage en mode stacked-die et en boîtier hermétique pour applications en milieu extrêmement contraint.	Stéphane BELLENGER, EOLANE
11:10 - 11:40	Contrôle automatique en 3D des dépôts de brasure sur C.I. en cours de câblage et après sérigraphie.	Emmanuel ANGLADE, METRONELEC
11:40 - 12:10	Glue-feeder SIPLACE: dépose de points de colle pour collage sélectif.	Thierry CHARLOT, ASM ASSEMBLY SYSTEMS
12:10 - 14:00	apéritif offert par le GFIE - DEJEUNER.	
14:00 - 14:30	En quoi la technologie 3D bouleverse les habitudes et sera généralisée dans les 5 années à venir.	Richard COLONNA, SEICA - OMRON
14:30 - 15:00	Développement de crèmes à braser basse température base Sn-Bi-Ag pour l'assemblage électronique, version nettoyable et no clean.	Emmanuelle GUENE, INVENTEC
14:30 - 15:00	Solder flux bearing leads (connecteurs avec apport de soudure)	Frank SUBTIL, COTELEC TEKA
15:30 - 16:00	PAUSE	
16:00 - 16:30	Protection of electronics with thin 3M Novec fluoropolymer coatings.	Catherine SOL, 3M Electronics Materials Solutions Department.
16:30 - 17:00	Brasage à la vague: étude comparative des coûts d'utilisation de machines sous air, partiellement sous azote et entièrement sous azote.	Georges BOUVIER, SEICA
17:00 - 17:30	Discussion	
17:30	Clôture	

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Jean LEPAGNOL,  
responsable du Comité Technique du GFIE.  
email: [jhlepagnoi-cti@gfie.fr](mailto:jhlepagnoi-cti@gfie.fr)  
téléphone: 06 11 08 28 45